

請求の範囲

- [請求項1] 基材層と、ヒートシール層と、を少なくとも有し、
 前記ヒートシール層が、ポリスチレン系樹脂（A）及びエチレンー
 （メタ）アクリル酸系共重合体（B）を含有し、
 前記（A）成分及び前記（B）成分の含有量がそれぞれ、前記（A）
 成分及び前記（B）成分の合計100質量部に対して、80質量部
 超95質量部以下及び5質量部以上20質量部未満である、カバーテ
 ープ。
- [請求項2] 前記（A）成分が、スチレン系炭化水素と共役ジエン系炭化水素と
 の共重合体と耐衝撃性ポリスチレンとを含む、請求項1に記載のカバ
 ーテープ。
- [請求項3] 前記（B）成分が、エチレンーメタクリル酸メチル共重合体を含む
 、請求項1又は2に記載のカバーテープ。
- [請求項4] 収容部を有するキャリアテープと、前記キャリアテープの前記収容
 部に収容された電子部品と、蓋材として前記キャリアテープにヒート
 シールされた請求項1～3のいずれか一項に記載のカバーテープと、
 を備える、電子部品包装体。